2013 年 4 月 23 日

プレスリリース

ルネサス エレクトロニクスが
DMP の 3D グラフィックス IP コア「SMAPH®-S」を採用

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(本社: 東京都中野区、東証マザーズ: 証券コード 3652、代表取締役社長 CEO 山本達夫、以下 DMP)は、ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都千代田区、東証 1 部:証券コード 6723、代表取締役社長 鶴丸 哲哉)の SoC に DMP の 3D グラフィックス IP コア「SMAPH-S」が採用されたことを発表しました。

SMAPH-S は、DMP の高度な技術力により、最小エリアサイズで、高いグラフィックス性能と低消費電力の両立を実現し、最新版のグラフィックス標準規格 OpenGL ES 3.0 に対応した 3D グラフィックス IP コアです。Android、Linux、Windows、VxWorks、μITORN など様々なプラットフォームをサポートしており、スマートフォンやタブレット等のモバイル機器からマルチファンクションプリンターやスマートテレビ等の据置き機器まで、幅広い製品アプリケーションに対応できます。とりわけコアサイズが競合製品よりも大幅に小さく消費電力が低いため、お客様のグラフィックス搭載機器の競争力向上に貢献しております。

DMP 代表取締役社長 CEO 山本達夫のコメント:
「ルネサス エレクトロニクス様に当社 3D グラフィックス IP コア「SMAPH-S」を採用していただき、大変光栄です。近年、スマートフォンを中心に様々な機器で豊かなグラフィックス表現が求められており、グラフィックス IP コアは必要不可欠なものとなっております。今回ルネサス エレクトロニクス様にご採用頂いたのは、当社のグラフィックス IP コアの高い性能を維持しながらも、最小エリアサイズと低消費電力を実現できることをご評価いただけたからだと考えております。DMP は今後も幅広いアプリケーションで培った経験や技術ノウハウを活かし、お客様のグラフィックスによる製品の表現力向上に貢献して参ります」

DMP は SMAPH-S を搭載した SoC を、日本最大の組込み技術展示会である、「第 16 回 組込みシステム開発技術展(ESEC 2013)」でデモ展示します。

〔第 16 回 組込みシステム開発技術展(ESEC 2013) 概要〕
会期 : 2013 年 5 月 8(水)～10 日(金)
時間 : 10:00～18:00 (最終日は 17:00 まで)
会場 : 東京ビッグサイト 西 2 ホール
ホームページ : http://www.esec.jp/
DMP 出展位置:ブース番号「西 9-11」

###

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)について 2002 年7月の会社設立以来、DMP(東証マザーズ: 証券コード 3652)は日本発のリーディング・テクノロジー・カンパニーとして、主に組込み市場向けに最適な 3D グラフィックス技術の開発を続けています。幅広い組込み製品をカバーするハード、ソフトを含む 3D グラフィックス・ソリューションにより、新しいユーザー体験を提供する事を目指しています。また Khronos グループのメンバーとして OpenGL ES の仕様策定に主導的役割を果たしています。DMP に関する情報は http://www.dmprof.com/ で入手できます。

©2013 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル DMP、DMP ロゴ、および SMAPH は株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本件に関するお問い合わせ先株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 広報担当:梅田／IR 担当:伊藤 TEL:03-6454-0495 e-mail:info_06@dmprof.comWeb サイト:
http://www.dmprof.com/company/inquiry_form/